

ASM



ENABLING THE DIGITAL WORLD

ASM E系列生产线

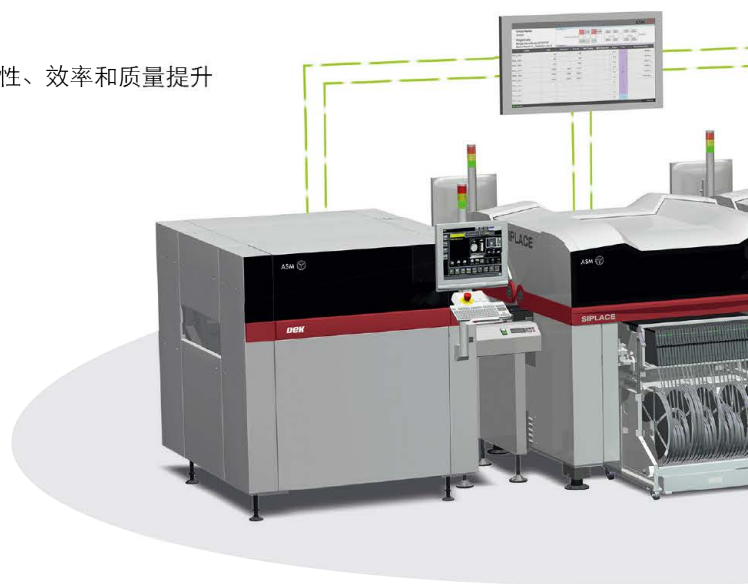
智能、高效、灵活

ASM E 系列生产线——通向 SMT 智慧工厂的钥匙

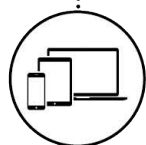
无论您是运营一个研发部门并制作原型、开展小批量生产还是提供生产服务——成本和灵活性在中速世界都扮演着重要的角色。

这就是我们为什么要开发 ASM E 系列生产线——一款强大高效的解决方案，可完美地与高质量硬件组件协作，这一方案为中速市场设置了新的标准。无需高级软件，我们将这款强大的套件组合在一起，为您的 SMT 生产线 workflow 提供完美的支持。

您的生产将变得更加智能，将整个 SMT 工厂的灵活性、效率和质量提升到一个新的高度。



智能软件



软件决定一切

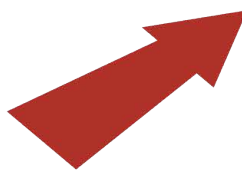
ASM E 系列生产线使用与运行在 ASM 高端解决方案中同样的高级软件——提高了整体的连接性，带来了更多选择，最大化投资保护。

使生产线的透明度最大化

为您的员工提供他们所需的所有信息，确保生产线顺畅无故障地运营。ASM Line Monitor 会显示状态信息，并协调生产线操作。

现代化软件向导

元器件示教、离线编程、优化——软件向导会引导您的操作员快速安全地完成最复杂的操作。



智能服务



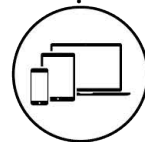
所有信息的来源都是单一的

ASM 既是 ASM E 系列生产线的开发者、生产商，也是所有技术和相关销售问题的直接联系人。销售、服务、SMT CoC（应用研究中心）、专家访问、快速备件供应、省时的视频培训研讨会——所有这些都是 ASM 为世界熟知的特征。拥有 ASM E 系列生产线，您也可以从我们的智能服务中受益。

智能 灵活性

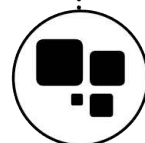
高级软件

使用与所有 ASM 解决方案（中速到高端市场）完全相同的机台和工作流软件



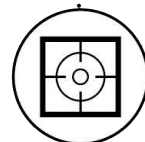
超大的元器件范围

01005 到
200 × 110 mm——仅使用
三个贴装头型号即可覆盖所有元器件范围



智能图像处理系统

每个元器件单独成像、每个元器件独立的光学设定、PCB 检查、异形元器件贴装、元器件破裂检查以及更多



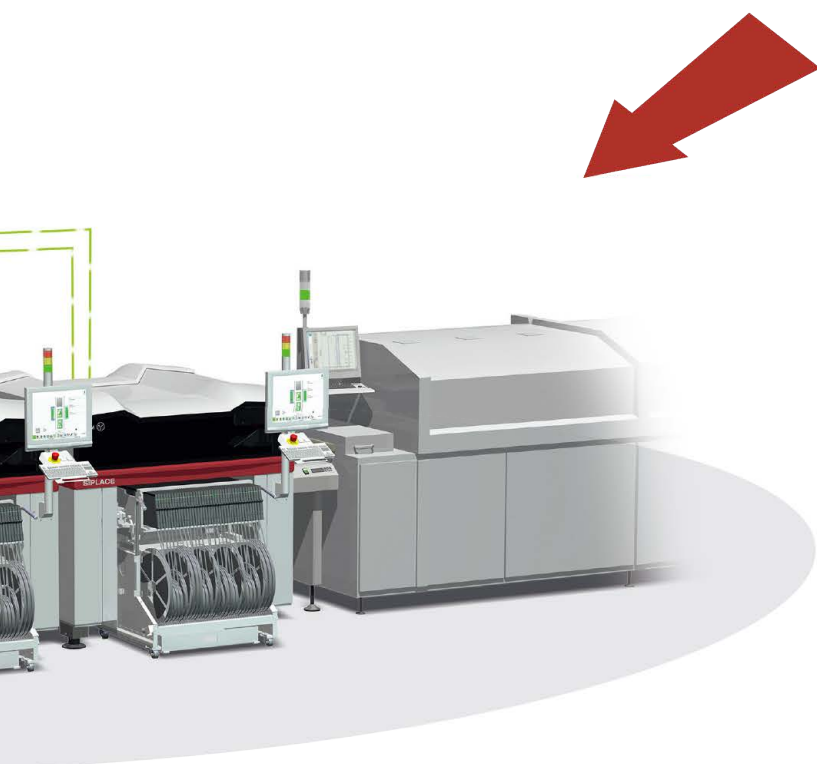
灵活的单轨传输

宽度自动调整和可选电路板长为
1,200 mm



非接触/低压力贴装

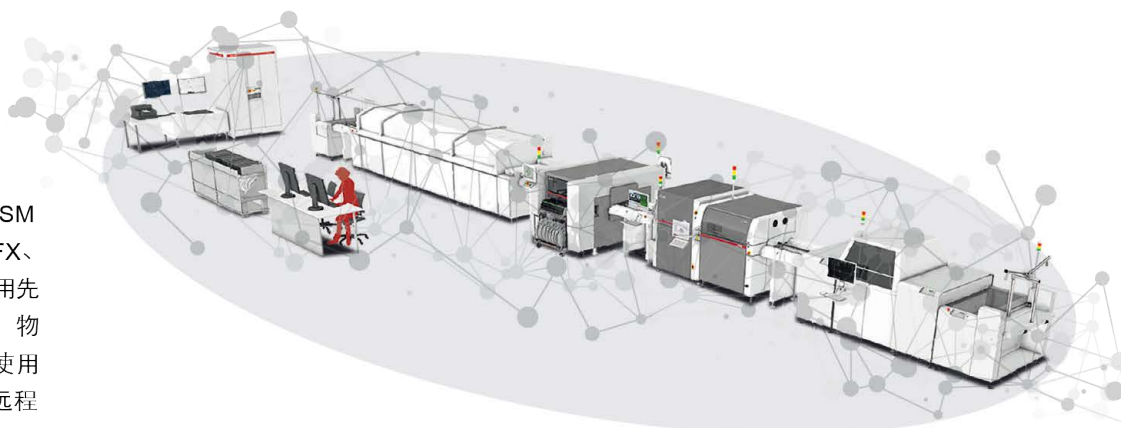
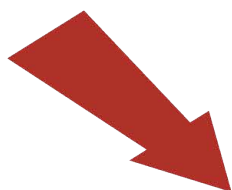
非接触贴装，贴装压力
低至 0.5 N



智能 连接性

与智慧工厂完美集成

IIoT 接口能与生产线和工厂系统（ASM OIB、IPC-HERMES-9852、IPC-CFX、MES）和云（ADAMOS）集成，使用先进的工作流解决方案进行流程设置、物料管理、工厂监控和工厂集成，还使用 ASM Remote Smart Factory 进行远程维护。



E BY DEK 与您的应用一样灵活

您的生产是否发生了变化？过去您不得不投资新的印刷模块，现在您只需要给您的模块化 E by DEK 添加选件即可——无论是传输导轨、超大型电路板、夹板、钢底清洁、监控和其他。

高级软件补充了我们的模块化硬件。与我们的顶级机型享有同样的功能：离线编程、快速换线、灵活配置以及轻松操作。所有这些使 E by DEK 变得极为灵活，并保护了您的投资。



E-性能

将您的 E by DEK 变为高速解决方案

- 核心周期低至 8 秒
- 双速传输马达支持软停机
- 先进的夹紧系统
- 半自动钢网加载
- 在速度、质量、转换效率和重复精度方面达到最高级别
- 应用套件可满足任何需求



E-质量

高质量和制程稳定性对您的客户重要吗？

- 即使是当今细间距应用，高质量的元器件也能确保稳定和可靠的印刷制程
- 锡膏检测系统
- 先进的制程控制软件
- DEK 锡膏高度监测



E-使用

最高的灵活性和生产稳定性

- 强大的高级软件具有直观的用户界面
- 使用 ASM Line Monitor 密切关注整条生产线
- 获得专利的夹紧系统可满足任何需求
- 支持超大和重型电路板
- 特殊的钢底清洁支持超大型电路板
- 双速传输马达
- 可调式钢网框架模组
- 半自动快速钢网加载



E-产品数据

机器性能	规格
校准	@ ±12.5 μm*
机器精度	> 2,0 C _{mk} @ ±25 μm, (6 sigma)**
最短的核心周期(CCT)	11 秒 (可选 8 秒)
操作系统	Windows 7 Standard embedded
刮板压力	软件控制、马达采用 ±1 kg 的闭环反馈
钢网定位	深度定位或者半自动钢网加载 (可选)
钢网框架	736 mm x 736 mm (29" x 29") 或者灵活的钢网宽度调整, 尺寸范围从 381 mm 到 736 mm, 框架厚度从 25 mm 到 38 mm (可选)
钢底清洁	300/400/520 mm DEK 可交换式钢网底部清洁装置 (DEK IUSC), 可编程为湿擦、干擦和真空擦
基板尺寸	50 mm (X) x 40.5 mm (Y) 到 510 mm (X) x 508.5 mm (Y)
基板厚度	0.2 mm 到 6 mm
换线	< 2 分钟***
程序创建	< 10 分钟***
基板夹紧	顶压式夹紧 (OTT) 侧夹 (可选) 底部真空 (可选)
温湿度感应器	监测进程环境温度湿度
锡膏验证	Hawkeye 750 (可选)

* 校准精度根据第三方 QC-Calc 软件计算, 包括基板加载/卸载、夹紧以及照相机系统和料车的移动。

** 设备能力根据第三方 QC-Calc 软件计算, 包括基板加载/卸载、夹紧以及照相机系统和料车的移动。

*** 在最优条件下。

E BY SIPLACE

灵活的多功能设备

E BY SIPLACE 是中速市场的新标杆。基于高质量硬件，采用线性驱动、先进的传输导轨、智能供料器、现代化的贴装头以及无偏差的 SIPLACE 图像处理系统。可进行编程、操作和监控，使用与高端 SIPLACE 平台功能相同且可靠的高级软件。

您可以访问我们的智能 workflow 解决方案；可以创建、优化并验证设置、程序和生产计划；通过 ASM Line Monitor 支持您的生产线员工；并且控制您的生产使之透明化和无纸化。

提供更高质量、提升性能和更容易操作的样机配置。



E-性能

配置您的 E by SIPLACE 以获得最佳性能

- 精密、快速和灵活的 SIPLACE 组合贴装头
- 自由编程贴装压力控制（低至 0.5N）
- SIPLACE 数字图像处理系统支持精确可靠贴装
- 智能、支持热插拔并且维护率低的供料器，具有精密的驱动器
- 供料台车支持快速换线——每台 E by SIPLACE 可容纳 120 个 8 mm 的料站位



E-质量

E by SIPLACE 在多功能领域市场设立了新的贴装质量标准

- 所有轴均采用高精度线性驱动
- 通过高分辨率缩放精确定位
- 自由编程贴装压力控制
- 高分辨率的 SIPLACE 数字图像处理系统
- 每个元器件单独成像，可配置的光学设定
- 广泛可靠的设置控制



E-使用

新标准操作简单，具有方便的用户指南，运行成本低。

- ASM Line Monitor 为生产线提供更高的透明度和可靠的操作员指导
- 灵活独特的 CP12/PP 组合贴装头
- 使用软件驱动在收集贴装和拾取贴装之间快速轻松地切换，支持广泛的电路板范围
- 软件向导支持快速轻松操作
- 灵活的设置理念
- 较低的部件维护率
- 高级软件支持使用现代化的 ASM workflow 解决方案



E-产品数据

贴装头	CP14	CP12	CP12/PP	TH
元器件范围	01005 到 6 x 6 mm	01005 到 18.7 x 18.7 mm	01005 到 45 x 87.5 mm	0201 到 200 x 110 mm
元器件高度	4 mm	7.5 mm	19 mm	25 mm
精度(3 sigma)	34 μm	41 μm	30 μm	30 μm
速度	45,300 cph	24,300 cph	24,200 cph	5,200 cph

贴装平台	E by SIPLACE			
贴装头	CP14, CP12, CP12/PP, TH			
PCB 大小(长 x 宽)*	1,200 x 460 mm			
PCB 厚度	0.3 to 4.5 mm			
供料器插槽	120 x 8 mm			
电源	3 x 200/208/220/240/380/400/415 VAC ± 10%, 50/60 Hz, 1.8 KW			
压缩空气	5.0 bar (0.5 MPa) - 10.0 bar (1.0 MPa)			
压缩空气要求	90 NL/min	90 NL/min	140 NL/min	185 NL/min
大小(长 x 宽)**	1,500 mm x 1,666 mm			
重量***	1,850 kg			

* PCB 长度从 490 mm 到 1200 mm, 仅支持长板选件

** 无需元器件车或料车

*** 单面

亿阳精密香港有限公司

香港九龙新蒲岗大有街32号泰立工业中心13楼12室

深圳市亿阳电子仪器有限公司

地址：深圳市光明新区华强创意产业园二期3栋C座604单元

电话：+86 755 8657 3062

手机：+86 189 2345 1117

www.billionsunshk.com